

現場報名表

星號*為必需填寫，請以正楷完整填寫。

尊稱*: 先生 小姐 女士 博士

姓名*: (中文) _____ (英文) _____

職稱*: (中文) _____ (英文) _____

公司名稱*: (中文) _____ (英文) _____

部門: _____ 城市: _____

電話*: (區碼: _____) _____ 手機*: _____

Email*: _____

1.* 您所在機構提供的主要產品 (服務)? (限選一項)

1. 消費性電子 (如音訊產品/影像產品/個人用電子產品/家用電器等)
2. 電腦及周邊設備 (如個人電腦/工作站/服務器/筆記型電腦/電腦週邊設備/影印機、傳真機及其他辦公室設備等)
3. 通訊系統 (如手機、對講機/物聯網和智能系統等)
4. 工業控制 (儀器和儀表等)
5. 汽車電子 (汽車資訊娛樂系統等)
6. 醫療、科學、測試儀器及設備 (醫療、科學電子設備等)
7. LED/顯示系統 (LED 照明/背光/顯示、面板/面板模組、其他 LED/顯示系統等)
8. 安防 (家庭監控系統、工廠/公共場所監控系統等)
9. 智慧電力/交通系統 (智慧電網/電錶、綠色能源、軌道交通設備)
10. IC 及零組件 (IC 設計、積體電路、分離式半導體設計)
11. 其他 (請註明) _____

2.* 您的主要職責: (限選一項)

1. 設計及開發工程 2. 工程管理 3. 一般管理和公司管理 4. 生產製造工程或生產測試工程
5. 品質保證或元件評估 6. 其他職責如市場/銷售業務、廣告業務等 7. 其它: (請註明) _____

3.* 您從事的設計項目 (可複選)

1. 通訊設計 2. 汽車電子設計 3. 類比/混合訊號 4. 無線電頻率/微波
5. 嵌入式系統 6. 電源管理 7. 光電子學 8. 軟體 / IP
9. 數位 10. 積體電路 11. 系統設計/結構/集成 12. 多晶片模組或印刷電路板
13. 專用積體電路/消費類 IC/可編程邏輯 14. 其它 (請註明) _____

* 我同意 AspenCore 服務條款和隱私政策

* 我願意收到你們的資訊及教育培訓資源速遞 (我瞭解可隨時退訂)

* 我同意接收協力廠商推送我感興趣的產品或服務郵件

* 我已閱讀「新加坡商意迪恩亞洲廣告有限公司台灣分公司個資蒐集聲明」，並同意新加坡商意迪恩亞洲廣告有限公司台灣分公司及合作夥伴於會後透過各種方式 (包含但不限於電話、電子郵件、簡訊、傳真及書面等方式) 與我聯繫。

簽署: _____

日期: _____